

芯盛智能科技有限公司

产品手册


PRODUCT BROCHURE

探索无限可能，持续为您赋能。

感谢您阅读本产品手册！

如需了解更多产品详情、技术更新或行业解决方案，欢迎关注我们的官方渠道。



 0731-88211113

 sales@xitcorp.com

 www.xitcorp.com

产品目录

Table Of Contents

1. 企业简介

1.1.1 芯盛智能介绍	P02
--------------	-----

2. 存储控制器芯片

2.1 SATA 控制器芯片

2.1.1 XT6110	P04
2.1.2 XT6120	P04
2.1.3 XT6121	P04
2.1.4 XT6160	P04

2.2 PCIe 控制器芯片

2.2.1 XT8111	P04
2.2.2 XT8211	P04
2.2.3 XT8310	P04

2.3 eMMC 控制器芯片

2.3.1 XT5521	P04
--------------	-----

3. 固态硬盘

3.1 SATA 企业级固态硬盘

3.1.1 SS2000SE	P06
3.1.2 SS6000SE	P07

3.2 SATA 工业级固态硬盘

3.2.1 DS1000	P08
3.2.2 DS2200 (准宽温)	P09
3.2.3 DS2200 (标温)	P10
3.2.4 DS2200 (宽温)	P11
3.2.5 DS2130	P12

3.3 SATA 消费级固态硬盘

3.3.1 ES2200	P13
3.3.2 ES2210	P14

3.4 PCIe 企业级固态硬盘

3.4.1 SP5000	P15
--------------	-----

3.5 PCIe 工业级固态硬盘

3.5.1 DP2100	P16
3.5.2 DP2100HE	P17

3.6 PCIe 消费级固态硬盘

3.6.1 EP2000Pro	P18
-----------------	-----

3.6.2 EP2100	P19
3.6.3 EP3000	P20

4. 嵌入式存储

4.1 eMMC

4.1.1 E110-X0I小容量	P22
4.1.2 E110-X0I大容量	P23

4.2 BGA SSD

4.2.1 US2200	P24
4.2.2 US2230	P25

5. 内存模组

5.1 DDR4

5.1.1 XAP40A SODIMM	P27
5.1.2 XAP40A UDIMM	P28
5.1.3 XAS40A RDIMM	P29

5.2 DDR5

5.2.1 XAP50A SODIMM	P30
5.2.2 XAP50A UDIMM	P31
5.2.3 XAS50A RDIMM	P32

6. 便携式存储

6.1 Micro SD卡 / Trans Flash卡

6.1.1 T100	P34
6.1.2 T150	P35

6.2 固态U盘

6.2.1 U2000	P36
6.2.2 U3000	P37
6.2.3 U3500	P38

6.3 移动固态硬盘

6.3.1 EM110	P39
-------------	-----

70%
研发人员占比

13亿+
累计研发投入

200+
授权专利

2,500万+
产品出货量
SATA | PCIe | eMMC | DDR
工业级 | 企业级 | 消费级

芯盛智能科技有限公司

芯盛智能科技（湖南）有限公司成立于 2018 年，是领先的存储控制器芯片及解决方案提供商。

公司研发人员占 70%，其中 30% 为硕士及以上学历，且具备 10 年以上 IC 设计与存储产品开发和量产经验。公司自成立以来，始终坚持自主创新理念，推出全球首款基于 RISC-V 架构的 12nm PCIe4.0 主控芯片、根据商密一级安全标准规范设计的 PCIe3.0 主控芯片、业界唯一一款基于 RISC-V 架构、内置独立 AI 算力、支持商用密码二级标准规范的 100% 全国产企业级 SATA3.0 主控芯片及数十款存储解决方案，产品覆盖数据中心、边缘计算、工业控制、消费类终端和车载电子等领域。

凭借雄厚的技术研发实力与丰富的行业经验积累，芯盛智能承担了多项省、市、区科研项目，形成多项拥有自主知识产权的关键核心技术，被评为高新技术企业、专精特新企业、瞪羚企业和年度质量信用 A 级企业等。

未来，公司将持续以自主知识产权为核心，推出更多符合不同客户不同应用场景的存储产品，构建数字经济的存力底座，让数据发挥更大价值，为国家网络信息安全和数字经济的发展贡献力量。

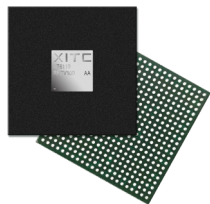


An abstract graphic of a circuit board pattern in light blue on a dark blue background. The pattern consists of numerous vertical lines of varying lengths, some with small circles at their ends, and some with horizontal segments, creating a complex, interconnected network of lines.

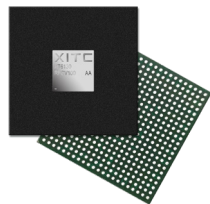
存储控制器芯片

Storage Controller Chip

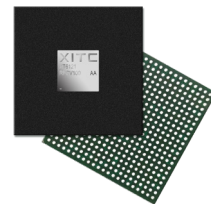
SATA控制器芯片



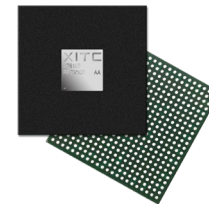
XT6110
SATA III, 4CH x 8CE
最大支持4TB
商密一级



XT6120
SATA III, 8CH x 4CE
最大支持8TB

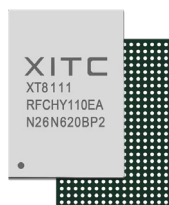


XT6121
SATA III, 2CH x 8CE
最大支持2TB
商密一级

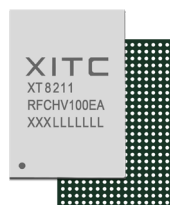


XT6160
SATA III, 8CH x 4CE
最大支持256TB
商密二级

PCIe控制器芯片



XT8111
PCIe 3.0 x 4, 4CH x 8CE
NVMe 1.3传输协议
最大支持8TB
商密一级



XT8211
PCIe 4.0 x 4, 4CH x 8CE
NVMe 1.4传输协议
最大支持8TB



XT8310
PCIe 5.0 x 4, 16CH x 8CE
NVMe 2.0传输协议
最大支持32TB

eMMC控制器芯片



XT5521
eMMC 5.1, 1CH x 4CE
最大支持128GB

An abstract graphic of a circuit board pattern in light blue on a dark blue background. The pattern consists of numerous vertical lines of varying lengths, some with horizontal segments at the top, and small circular nodes at the ends of the lines, creating a dense, grid-like structure.

固态硬盘

Solid State Drive

SS2000SE

SATA III



芯盛智能

2.5inch

► 产品简介/Product Introduction

SS2000SE 系列企业级 SATA SSD 产品是基于自主研发的主控 XT6120EN 和固件，并搭载 YMTC 新一代 3D TLC NAND Flash，为数据中心与企业级客户提供业界领先的高性能、低时延、高可靠、长寿命的 SSD。产品可广泛的用于企业数据中心、电信、互联网、金融与政府等行业，作为企业服务器与存储整列的系统盘与数据盘使用。

高性能读密集型SSD

产品为读密集型应用精心设计，可作为企业服务器和存储系统的启动盘、系统盘及数据盘。顺序读取性能可达 560 MB/s，随机读取性能高达 98K IOPS，可轻松应对各类高负载的读取任务。

国产化、自主可控

SS2000SE 系列企业级 SSD，其主控和固件由 XITC 完全自主研发，全面深度适配 YMTC 颗粒；产品具备从设计、制造、封测与生产全流程国产化，为用户提供自主可控、稳定可靠的产品供应与技术服务。

全方位数据可靠性保障

NANDXtra 数据可靠性引擎，通过智能磨损均衡技术，全局优化数据写入，有效提升了闪存的使用寿命和可靠性。同时，借助 ECC、LDPC、Read Retry 等技术，显著增强了数据纠错能力；并采用 RAID、数据巡检、高温保护以及坏块管理等技术，全方位保障盘片与数据的安全可靠。

► 应用场景/Application scenario



► 产品规格/Product specification

形态规格

2.5inch

可用容量(GB)

	480	960	1,920	3,840
TBW(TB) @ESD219 Enterprise Workload				

	876	1,752	3,504	7,008
--	-----	-------	-------	-------

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 520
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 98,000
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 45,000

功耗 (Watt)

≤1.6(idle); ≤4.0(active)

颗粒

YMTC 3D TLC

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

工作温度

0~70 °C(工作状态)
-40~+85 °C(存储状态)

平均无故障时间 (MTBF)

≥2,000,000 hours

不可纠正错误率 (UBER)

≤10⁻¹⁷

耐用性

1 DDPD
(5年, 数据写入量不超过 TBW)

振动 / 冲击

3.13G @ 5~800 Hz
1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

增强 PLP、E2E、RAID+、ECC、4K LDPC、高温保护、TRIM、
在线升级、SMART、AES256(可选) 等

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

SS6000SE

SATA III



2.5inch

M.2 2280

产品简介/Product Introduction

SS6000SE 系列 SATA SSD 使用长江存储 Xtacking 4.0 3D TLC 闪存颗粒，结合芯盛智能自研的固件算法和智能块管理技术 (IBMT)，通过对闪存读写机制的深度优化，极大地提升了产品的性能、可靠性和性价比。容量覆盖 240GB 至 7.68TB，打造一站式企业级 SATA SSD 解决方案。

高性能企业级SSD

产品面向读写密集型与读写混合型应用设计，可作为企业服务器和存储系统的启动盘、系统盘及数据盘。顺序读取性能可达 560 MB/s，随机读取性能高达 98K IOPS，可轻松应对各类高负载的读取任务。

全国产化自主可控

产品搭载了芯盛智能全新的 XT6160 主控芯片，基于 RISC-V 架构设计，所有 IP 均为国产，核心 IP 更是自主研发，在国内晶圆代工厂完成流片，并由国内封装厂进行封装与测试，实现了全产业链的国产化。

全方位数据可靠性保障

NANDXtra 数据可靠性引擎，通过智能磨损均衡技术，全局优化数据写入，有效提升了闪存的寿命和可靠性。同时，借助 ECC、LDPC、Read Retry 等技术，显著增强了数据纠错能力；并采用 RAID、数据巡检、高温保护以及坏块管理等技术，全方位保障盘片与数据的安全可靠。

应用场景/Application scenario



产品规格/Product specification

形态规格

	2.5inch					M.2 2280-B-M		
可用容量(GB)	480	960	1,920	3,840	7,680	240	480	960
TBW(TB) @ESD219 Enterprise Workload								
读密集型	876	1,752	3,504	7,008	14,016	438	876	1,752
读写混合型	2,628	5,256	10,512	21,024				

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 560	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 520/530	Up to 520
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 98,000	Up to 95,000
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 50,000/80,000	Up to 30,000
功耗 (Watt)	≤1.4(idle); ≤3.0(active)	≤1.1(idle); ≤3.0(active)

振动 / 冲击

	3.13G @ 5~800 Hz 1,000G @ 0.5 ms, 3 axis	20G @ 20~2,000 Hz 1,500G @ 0.5 ms, 3 axis
--	---	--

颗粒

YMT3D TLC

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

工作温度

0~70 °C(工作状态)
-40~+85 °C(存储状态)

平均无故障时间(MTBF)

≥2,500,000 hours

不可纠正错误率(UBER)

≤10⁻¹⁷

耐用性

1 DWPD
(5年,数据写入量不超过TBW)
3 DWPD(2.5inch)
(5年,数据写入量不超过TBW)

特性

4K LDPC、RAID、SRAM ECC、DRAM ECC、E2EDP、TRIM、SMART

高温保护、掉电保护、在线升级、安全启动、国密(可选)、TCG Opal2.0(可选)

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

DS1000

SATA III



2.5inch

mSATA

► 产品简介/Product Introduction

DS1000 系列是芯盛最新的高性能、高可靠工业级 SATA SSD，主要应用于高可靠宽温领域。DS1000 系列 SSD 以芯盛自研全国产 XT6110 SATA SSD 控制器和高可靠 gTLC 为基础，实现了业内领先的性能、可靠性和兼容性。

自研国产主控

该产品搭载的 XT6110 主控是国内首创基于龙芯 CPU IP 核打造的全国产 SATA DRAM-Base 高性能工业级主控芯片，真正实现了国内设计、国内流片、国内封测的全链条自主可控。

介质分析成果转化

芯盛智能将介质分析成果充分应用在固件算法中，让数据在 Data Retention、Read Disturb、高写低读、低写高读、跨温域读写等各种场景下都能保持很好的完整性与一致性。

工业级特性

全系支持硬件级掉电保护；
 全系支持智能数据销毁；
 全系支持抗硫化设计；
 全系支持 Under fill, Side fill, 三防涂覆等工艺定制。

► 应用场景/Application scenario



► 产品规格/Product specification

形态规格

	2.5inch			mSATA		
可用容量(GB)	1,024	2,048	4,000	512	1,024	2,048
TBW(TB) @ESD218 Client Workload	1,440	2,880	5,760	720	1,440	2,880

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 490
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 86,800
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 83,600

功耗 (Watt)

	≤1.1(idle); ≤3.2(active)	≤1(idle); ≤2.8(active)
颗粒	产品接口	工作温度
KIOXIA Bics5	SATA III (6.0Gbps)	-40~85°C(工作状态) -55~95 °C(存储状态)
平均无故障时间 (MTBF)	不可纠正错误率 (UBER)	振动 / 冲击
≥2,000,000 hours	≤10 ⁻¹⁶	15G @ 10~2,000 Hz 1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

宽温 (-40°C~85°C)应用、直写模式、软销毁功能、PLP 掉电保护

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second
 2. 以上性能数据是在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和环境的差异可能存在偏差

DS2200准宽温

SATA III



► 产品简介/Product Introduction

芯盛 DS2200 全国产准宽温系列产品是以芯盛新一代 SATA 主控架构为技术核心，采用全新自研直写固件，搭配 YMTC 3D TLC 闪存颗粒，并结合 3D TLC 应用技术打造的全新工业级产品。该系列产品有较好的耐久性，能够在 -20°C~75°C 标温条件下稳定运行。该系列产品规格覆盖 M.2 2242、M.2 2280、mSATA、2.5 寸四种尺寸规格，容量从 64GB~2TB 均有覆盖。

自研国产主控

该产品搭载的 XT6121 主控是国内首创基于龙芯 CPU IP 核打造的全国产 SATA DRAM-Less 低功耗工业级主控芯片，真正实现了国内设计、国内流片、国内封测的全链条自主可控。

介质分析成果转化

芯盛智能将介质分析成果充分应用在固件算法中，让数据在 Data Retention、Read Disturb、高写低读、低写高读、跨温域读写等各种场景下都能保持很好的完整性与一致性。

个性化定制

全系 100% 国产化 BOM 设计；内置硬件级加密算法模块，支持权限控制、PBA 预引导启动、全盘及分区加密、隐藏分区等安全特性定制。

► 应用场景/Application scenario



► 产品规格/Product specification

形态规格

2.5inch	mSATA	M.2 2280	M.2 2242
可用容量(GB)			
128~2,048	64~2,048	128~1,024	64~1,024
TBW(TB) @ESD218 Client Workload			
120~2,000	60~2,000	120~1,000	60~1,000

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 410
4K 随机读 IOPS	Up to 57,000
4K 随机写 IOPS	Up to 64,000

功耗 (Watt)

≤0.6 (idle)
≤1.3 (active)

颗粒

YMTC 3D TLC

平均无故障时间 (MTBF)

≥2,000,000 hours

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

不可纠正错误率 (UBER)

≤10⁻¹⁶

工作温度

-20~75 °C (工作状态)
-40~85 °C (存储状态)

振动 / 冲击

15G @ 10~2,000 Hz
1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

支持安全擦功能

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能数据是在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得，性能数据因测试工具和环境的差异可能存在偏差

DS2200 标温

SATA III



产品简介 / Product Introduction

DS2200 系列全国产标温产品是以芯盛新一代架构主控为技术核心，采用自研全新直写固件，搭配 YMTC 3D TLC 闪存颗粒，并结合芯盛智能颗粒应用技术打造的新一代工业级产品。该系列产品有较好的耐久性，能够在 -0°C~70°C 标温条件下稳定运行。该系列产品规格齐全，覆盖 mSATA、2.5 寸、2280 和 2242 四种尺寸规格，容量从 64GB~1TB 均有覆盖。

自研国产主控

该产品搭载的 XT6121 主控是国内首创基于龙芯 CPU IP 核打造的全国产 SATA DRAM-Less 低功耗工业级主控芯片，真正实现了国内设计、国内流片、国内封测的全链条自主可控。

介质分析成果转化

芯盛智能将介质分析成果充分应用在固件算法中，让数据在 Data Retention、Read Disturb、高写低读、低写高读、跨温域读写等各种场景下都能保持很好的完整性与一致性。

个性化定制

全系 100% 国产化 BOM 设计；内置硬件级加密算法模块，支持权限控制、PBA 预引导启动、全盘及分区加密、隐藏分区等安全特性定制。

应用场景 / Application scenario



产品规格 / Product specification

形态规格

2.5inch	mSATA	M.2 2280	M.2 2242
可用容量(GB)			
128~1,024	64~1,024	128~1,024	64~512
TBW(TB) @ESD218 Client Workload			
120~1,000	60~1,000	120~1,000	60~500

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 440
4K 随机读 IOPS	Up to 60,000
4K 随机写 IOPS	Up to 62,000

功耗 (Watt)

≤0.6 (idle)	≤0.6 (idle)	≤0.6 (idle)	≤0.6 (idle)
≤1.3 (active)	≤1.2 (active)	≤1.1 (active)	≤1.1 (active)

颗粒

YMTC 3D TLC

平均无故障时间 (MTBF)

≥2,000,000 hours

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

不可纠正错误率 (UBER)

≤10⁻¹⁶

工作温度

0~70 °C (工作状态)
-40~85 °C (存储状态)

振动 / 冲击

15G @ 10~2,000 Hz
1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

支持安全擦功能、全国产器件 BOM、全盘 SLC Cache 功能

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能数据是在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得，性能数据因测试工具和环境的差异可能存在偏差

DS2200宽温

SATA III



► 产品简介/Product Introduction

DS2200 系列全国产宽温产品是以芯盛新一代架构主控为技术核心, 采用自研全新直写固件, 搭配 YMTC 工规级 TLC 闪存颗粒, 并结合芯盛智能颗粒应用技术打造的新一代工规级产品。该系列产品有较好的耐久性, 能够在 -40°C~85°C 标温条件下稳定运行。该系列产品规格齐全, 覆盖 mSATA、2.5 寸、2280 和 2242 四种尺寸规格, 容量从 128GB~2TB 均有覆盖。

自研国产主控

该产品搭载的 XT6121 主控是国内首创基于龙芯 CPU IP 核打造的全国产 SATA DRAM-Less 低功耗工业级主控芯片, 真正实现了国内设计、国内流片、国内封测的全链条自主可控。

介质分析成果转化

芯盛智能将介质分析成果充分应用在固件算法中, 让数据在 Data Retention、Read Disturb、高写低读、低写高读、跨温域读写等各种场景下都能保持很好的完整性与一致性。

工业级特性

全系支持硬件级掉电保护; 全系支持智能数据销毁; 全系支持抗硫化设计; 全系 100% 国产化 BOM 设计; 全系支持 Under fill, Side fill, 三防涂覆等工艺定制; 内置硬件级加密算法模块, 支持权限控制、PBA 预引导启动、全盘及分区加密、隐藏分区等安全特性定制。

► 应用场景/Application scenario



► 产品规格/Product specification

形态规格

形态规格	2.5inch	mSATA	M.2 2280	M.2 2242
可用容量(GB)	128~2,048	128~2,048	512~2,048	128~512
TBW(TB) @ESD218 Client Workload	120~2,000	120~2,000	500~2,000	120~500

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 410
4K 随机读 IOPS	Up to 41,000
4K 随机写 IOPS	Up to 51,000

功耗 (Watt)

≤0.6 (idle)
≤1.5 (active)

颗粒

YMTC 3D TLC

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

工作温度

-40~85 °C(工作状态)
-55~95°C(存储状态)

平均无故障时间 (MTBF)

≥2,000,000 hours

不可纠正错误率 (UBER)

≤10⁻¹⁶

振动 / 冲击

20G @ 10~2,000 Hz
1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

抗硫化、数据销毁、PLP 掉电保护、全国产器件 BOM

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能数据是在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和环境的差异可能存在偏差

DS2130

SATA III



► 产品简介/Product Introduction

DS2130 系列全国产宽温产品是以芯盛新一代架构主控为技术核心，采用自研全新直写固件，搭配 YMC 3D TLC 闪存颗粒，并结合芯盛智能 Xtrans-SLC 应用技术打造的新一代工规级产品。该系列产品有较好的耐久性，能够在 -40°C~85°C 标温条件下稳定运行。该系列产品规格齐全，覆盖 mSATA、2.5 寸和 2242 三种尺寸规格，容量从 8GB~128GB 均有覆盖。

自研国产主控

该产品搭载的 XT6121 主控是国内首创基于龙芯 CPU IP 核打造的全国产 SATA DRAM-Less 低功耗工业级主控芯片，真正实现了国内设计、国内流片、国内封测的全链条自主可控。

介质分析成果转化

芯盛智能将介质分析成果充分应用在固件算法中，让数据在 Data Retention、Read Disturb、高写低读、低写高读、跨温域读写等各种场景下都能保持很好的完整性与一致性。

高寿命

该产品搭载国产 YMTC 3D TLC 颗粒，结合芯盛智能独有的 Xtra-SLC 颗粒应用技术，实现了高达 100K 的擦写次数。

► 应用场景/Application scenario



► 产品规格/Product specification

形态规格

	2.5inch	mSATA	M.2 2242
可用容量(GB)	128	8~64	8~32
TBW(TB) @ESD218 Client Workload	2,560	380~1,280	380~800

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 400
4K 随机读 IOPS	Up to 49,000
4K 随机写 IOPS	Up to 61,000

功耗 (Watt)

≤0.6 (idle); ≤1.5 (active)

颗粒

YMTC 3D TLC(pSLC 应用)

平均无故障时间 (MTBF)

≥2,000,000 hours

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

不可纠正错误率 (UBER)

≤10⁻¹⁶

工作温度

-40~85°C (工作状态)
-55~95 °C (存储状态)

振动 / 冲击

20G @ 10~2,000 Hz
1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

抗硫化、全国产器件 BOM、高寿命

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能数据是在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得，性能数据因测试工具和环境的差异可能存在偏差

ES2200

SATA III



2.5inch

► 产品简介 / Product Introduction

ES2200 系列产品固态硬盘(SSD)采用 YMTC 3D TLC NAND 闪存, 提供更高性能、更低延迟、更低功耗的存储设备。SSD 与机械硬盘具有相同的主机接口和物理尺寸, 可以做到快速替换, 该系列产品有较好的耐久性, 能够在 0°C~70°C 标温条件下稳定运行。本系列提供 2.5 英寸 256GB、512GB、1TB、2TB 四种容量规格。

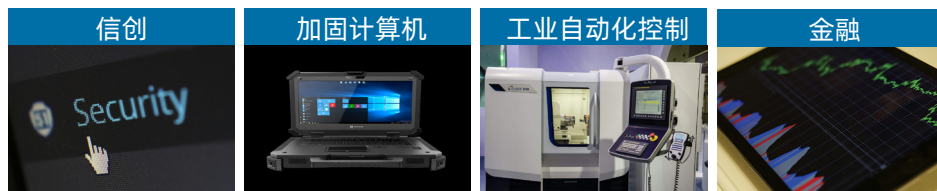
高性价比、高适用

采用成熟的设计方案, 替换 HDD 应用价格更有优势, 对多平台和环境适用性高。

可靠且稳定

专有 LDPC 纠错码 (ECC) 及数据保护技术, 使 3D TLC 固态硬盘的 P/E 循环次数提升三倍, 支持静态数据刷新技术确保数据完整性, 更高性能、更低延迟、更低功耗。

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

形态规格

2.5inch

可用容量(GB)

	256	512	1,024	2,048
TBW(TB) @ESD218 Client Workload				

125 250 500 1000

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 550
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 510
4K 随机读 IOPS	Up to 72,000
4K 随机写 IOPS	Up to 77,000

功耗 (Watt)

≤0.3(idle);≤1(active)

颗粒

3D TLC

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

工作温度

0~70°C(工作状态)
-40~85 °C(存储状态)

平均无故障时间 (MTBF)

≥1,500,000 hours

振动 / 冲击

1,500G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

专有 LDPC 纠错码 (ECC) 及数据保护技术, 使 3D TLC 固态硬盘的 P/E 循环次数提升三倍; 全局磨损均衡算法均衡编程 / 擦除次数, 延长固态硬盘使用寿命; 静态数据刷新技术确保数据完整性

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能数据是在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和环境的差异可能存在偏差

ES2210

SATA III



2.5inch

► 产品简介 / Product Introduction

ES2210 系列产品固态硬盘(SSD)采用 3D QLC NAND 闪存, 提供更高性价比、更低延迟、更低功耗的存储设备。SSD 与机械硬盘具有相同的主机接口和物理尺寸, 可以做到快速替换, 该系列产品有较好的耐久性, 能够在 0°C~70°C 标温条件下稳定运行。本系列提供 2.5 英寸 512GB、1TB 两种容量规格。

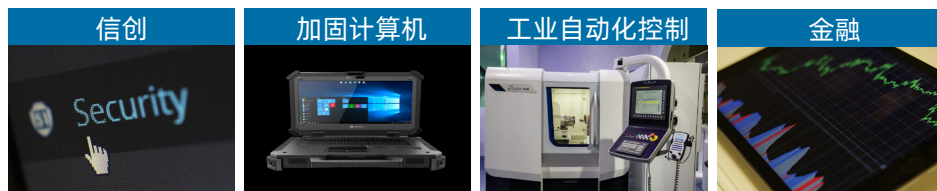
高性价比、高适用

采用成熟的设计方案, 替换 HDD 应用价格更有优势, 对多平台和环境适用性高。

可靠且稳定

专有 LDPC 纠错码(ECC)及数据保护技术, 使 3D TLC 固态硬盘的 P/E 循环次数提升三倍, 支持静态数据刷新技术确保数据完整性, 更高性能、更低延迟、更低功耗。

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

形态规格

2.5inch

可用容量(GB)

512

1,024

TBW(TB)

@ESD218 Client Workload

150

300

性能

128KB 顺序读(MB/s)

Up to 554

128KB 顺序写(MB/s)

Up to 521

功耗 (Watt)

≤0.3(idle);≤1.7(active)

颗粒

3D QLC

产品接口

SATA III (6.0Gbps)

工作温度

0~70°C(工作状态)
-40~85 °C(存储状态)

平均无故障时间(MTBF)

≥1,500,000 hours

振动 / 冲击

1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

专有 LDPC 纠错码(ECC)及数据保护技术, 使 3D TLC 固态硬盘的 P/E 循环次数提升三倍; 全局磨损均衡算法均衡编程 / 擦除次数, 延长固态硬盘使用寿命; 静态数据刷新技术确保数据完整性

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能数据是在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和环境的差异可能存在偏差

SP5000

PCIe 5.0



U.2 15mm

产品简介/Product Introduction

SP5000 系列企业级 PCIe SSD 是一款高性能存储解决方案，基于芯盛智能主控 XT8310，采用 2.5 英寸 U.2 形态和 PCIe Gen5 x4 接口，容量范围从 1.6TB 到 30.72TB，支持 1 DWPD 和 3 DWPD 两种写入寿命。该系列符合 NVMe 2.0 和 NVMe-MI 1.2b 规范，具备全数据路径保护、掉电数据保护、安全擦除和在线固件升级等企业级功能，为数据中心和企业客户提供高性价比的 SSD 选择。

双端口设计

双端口设计提供两条独立的资料通道，确保在一个通道故障时，系统仍可通过另一通道存取资料，提升资料存取的稳定性和可靠性。

数据可靠性

全路径数据保护
增强掉电数据保护
>10⁻¹⁸ 资料可靠性

高可服务性

支持 NVMe-MI
在线固件升级
标准接口日志收集

应用场景/Application scenario



产品规格/Product specification

形态规格

U.2 15mm

可用容量(TB)

	1.92	3.84	7.68	15.36	30.72
	1.6	3.2	6.4	12.8	25.6

TBW(TB)

@ESD219 Enterprise Workload

	3,504	7,008	14,016	28,032	56,064
	8,760	17,520	35,040	70,080	140,160

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 14,000
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 8,500
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 3,000,000
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 900,000

功耗 (Watt)

≤9(idle); ≤25(active)

颗粒

3D TLC

产品接口

PCIe Gen5.0

工作温度

0~70 °C(工作状态)
-40~+85 °C(存储状态)

平均无故障时间(MTBF)

≥2,500,000 hours

不可纠正错误率(UBER)

≤10⁻¹⁸

耐用性

1 DWPD(1.92TB~30.72TB)
(5年,数据写入量不超过TBW)
3 DWPD(1.6TB~25.6TB)
(5年,数据写入量不超过TBW)

振动 / 冲击

16.3G @ 10~2000 Hz
1,000G @ 0.5 ms

特性

S.M.A.R.T 特性、TRIM 命令、PLP 断电保护、E2E 端到端数据保护、AES-XTS 256 硬件加密、SRAM ECC、高温保护、盘内 RAID、在线升级、热插拔

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

DP2100

PCIe 3.0



M.2 2242

产品简介/Product Introduction

固态硬盘 SSD DP2100 搭载 PCIe3.0 控制器芯片, 采用 3D TLC NAND, 具备 PCIe3.0x4 高速接口, 支持 NVMe1.4 协议, 被广泛应用于工控机、工业自动化、工业黑匣、工业 IPC、光纤终端机、迷你电脑、开发板、过程控制单元、数据记录器等场景中, 是全场景覆盖的工业级固态硬盘解决方案。

自研国产主控

该产品搭载基于 RISC-V 架构自主研发的芯盛 XT8111 主控, 用户带来了安全高效的数据存储体验, 助力自研存储创新应用升级。

可靠、稳定、高效

RAID 功能, 可靠性提升 122 倍; SRAM ECC 功能, 保障数据完整性; 采用 3D TLC NAND 及自研智能块管理技术, 延长使用寿命并适应极端温度; DRAM-less 设计降低掉电风险, 支持 PLN/PLA 功能, 缓存保护效率提升 5 倍。

个性化定制

支持定制化硬件、固件特性, 业务范围辐射全国, 为客户提供更好的服务与支持。

应用场景/Application scenario

迷你电脑



工业黑匣



工业开发板



工业IPC



服务器板卡



工业过程控制



产品规格/Product specification

形态规格

M.2 2242

可用容量(GB)

	256	512	1,024	2,048
--	-----	-----	-------	-------

TBW(TB)

@JE5D219 Client Workload

	320	650	1300	2600
--	-----	-----	------	------

性能

128KB 顺序读(MB/s)	Up to 2,480
128KB 顺序写(MB/s)	Up to 2,285
4K 随机读(稳态)IOPS	Up to 249,000
4K 随机写(稳态)IOPS	Up to 284,000

功耗(Watt)

≤4m(idle); ≤1.6(active)

颗粒

3D TLC

产品接口

PCIe Gen 3.0

工作温度

0~70 °C(工作状态)
-40~+85 °C(存储状态)

平均无故障时间(MTBF)

≥1,500,000 hours

不可纠正错误率(UBER)

≤10⁻¹⁶

耐用性

0.7 DWPD
(5 年, 数据写入量不超过 TBW)

振动 / 冲击

20G @ 20~2000 Hz
1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

ATA Security 加密功能、安全擦功能、ECC 等纠错功能
Host Led 功能、PLN 功能

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

DP2100HE

PCIe 3.0



M.2 2242

产品简介/Product Introduction

固态硬盘 SSD DP2100HE 搭载 PCIe3.0 控制器芯片, 采用 3D TLC NAND, 具备 PCIe3.0x4 高速接口, 支持 NVMe1.4 协议, 被广泛应用于工控机、工业自动化、工业黑匣、工业 IPC、光纤终端机、迷你电脑、开发板、过程控制单元、数据记录器等场景中, 是全场景覆盖的工业级固态硬盘解决方案。

自研国产主控

该产品搭载基于 RISC-V 架构自主研发的芯盛 XT8111 主控, 用户带来了安全高效的数据存储体验, 助力自研存储创新应用升级。

可靠、稳定、高效

RAID 功能, 可靠性提升 122 倍; SRAM ECC 功能, 保障数据完整性; 采用 3D TLC NAND 及自研智能块管理技术, 延长使用寿命并适应极端温度; DRAM-less 设计降低掉电风险, 支持 PLN/PLA 功能, 缓存保护效率提升 5 倍。

个性化定制、高寿命

支持定制化硬件、固件特性, 业务范围辐射全国, 为客户提供更好的服务与支持。产品搭载国产 YMTC 3D TLC 颗粒, 结合芯盛智能独有的 Xtra-SLC 颗粒应用技术, 实现了高达 100K 的擦写次数。

应用场景/Application scenario

迷你电脑



工业黑匣



工业开发板



工业IPC



服务器板卡



工业过程控制



产品规格/Product specification

形态规格

M.2 2242

可用容量(GB)

dTLC

pSLC

	32	64	128	240	16	32	64	128
TBW(TB) @JE5D219 Client Workload	50	100	200	400	625	1250	2500	5000

性能

128KB 顺序读(MB/s)	Up to 3,300
128KB 顺序写(MB/s)	Up to 2,400
4K 随机读(稳态)IOPS	Up to 450,000
4K 随机写(稳态)IOPS	Up to 400,000

功耗(Watt)

≤0.4(idle); ≤1.1(active)

颗粒

3D TLC

产品接口

PCIe Gen 3.0

工作温度

0~70 °C(工作状态)
-40~+85 °C(存储状态)

平均无故障时间(MTBF)

≥2,000,000 hours

不可纠正错误率(UBER)

≤10⁻¹⁶

耐用性

0.88DWPD
(5 年, 数据写入量不超过 TBW)

振动 / 冲击

20G @ 10~2000 Hz
1,000G @ 0.5 ms, 3 axis

特性

ATA Security 加密功能、安全擦功能、ECC 等纠错功能
Host Led 功能、PLN 功能

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second
2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

EP2000 Pro

PCIe 3.0



M.2 2280

产品简介/Product Introduction

XITC EP2000 Pro 搭载芯盛智能 PCIe3.0 控制器芯片，采用 3D TLC NAND，具备 PCIe3.0 x 4 高速接口，支持 NVMe1.4 协议，其内置 NANDXtra® 和 NANDSafe™ 应用技术，大大增加了颗粒的耐久性和可靠性，被广泛应用于笔记本、工作站、一体机、瘦终端、OPS、台式机、游戏主机中，是全场景覆盖的桌面级固态硬盘解决方案。

自研国产主控

该产品搭载基于 RISC-V 架构自主研发的芯盛 XT8111 主控，用户带来了安全高效的数据存储体验，助力自研存储创新应用升级。

高性能，高效率

EP2000Pro 系列内置芯盛智能高速 Flash io、动态 SLC Cache 技术，性能和同类型国外 PCIe3.0 产品相比，在文字处理、表格、幻灯片等办公文件的打开速度上提升 15%~25%，同时打开影院、浏览器、社交等应用软件的速度同步提升 5%~20%。

强兼容，长寿命

EP2000Pro 兼容 windows、麒麟、UOS 等全主流平台，满足办公、游戏及设计等工作场景，其内置 NANDXtra® 和 NANDSafe™ 应用技术，大大增加了颗粒的耐久性和可靠性，被广泛应用于笔记本、工作站、一体机、瘦终端、OPS、台式机、游戏主机中，是全场景覆盖的桌面级固态硬盘解决方案。

应用场景/Application scenario



产品规格/Product specification

形态规格

M.2 2280

可用容量(GB)

	256	512	1,024	2,048
TBW(TB) @JE5D219 Client Workload	150	300	600	1200

性能

128KB 顺序读(MB/s)	Up to 3,500
128KB 顺序写(MB/s)	Up to 3,400
4K 随机读(稳态)IOPS	Up to 520,000
4K 随机写(稳态)IOPS	Up to 590,000

功耗(Watt)

≤0.1(idle); ≤3.7(active)

颗粒

3D TLC

产品接口

PCIe Gen 3x4

工作温度

0~70/-20~70 °C(工作状态)
-40~+85 °C(存储状态)

平均无故障时间(MTBF)

≥1,500,000 hours

不可纠正错误率(UBER)

≤10⁻¹⁶

耐用性

0.55 DWPD
(3年, 数据写入量不超过 TBW)

振动 / 冲击

20G @ 20~2000 Hz
1,500G @ 0.5 ms, 3axis

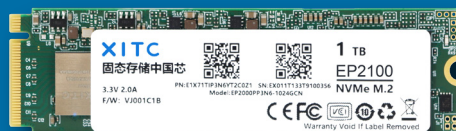
特性

ATA Security 加密功能、安全擦功能、ECC 等纠错功能、Host Led 功能

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second
2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得，性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

EP2100

PCIe 3.0



M.2 2280

产品简介/Product Introduction

XITC EP2100 是一款采用先进 NAND 闪存技术的高性能固态硬盘，完美替代传统机械硬盘。它摒弃了易损机械部件，具备卓越的耐用性、读写性能与能效。通过内置全局磨损均衡技术，EP2100 显著提升了平均无故障时间(MTBF)，确保长期稳定运行。其紧凑的标准外形与接口设计，可实现无缝兼容与便捷升级，是各类电脑设备的理想存储方案，能带来极速响应、低延迟及出色的能耗控制。

自研国产主控

该产品搭载基于 RISC-V 架构自主研发的芯盛 XT8111 主控，用户带来了安全高效的数据存储体验，助力自研存储创新应用升级。

高性能，高效率

EP2100 系列内置芯盛智能高速 Flash io、动态 SLC Cache 技术，性能和同类型国外 PCIe3.0 产品相比，在文字处理、表格、幻灯片等办公文件的打开速度上提升 15%~25%，同时打开影院、浏览器、社交等应用软件的速度同步提升 5%~20%。

强兼容，长寿命

EP2100 兼容 windows、麒麟、UOS 等全主流平台，满足办公、游戏及设计等工作场景，其内置 NANDXtra® 和 NANDSafe™ 应用技术，大大增加了颗粒的耐久性和可靠性，被广泛应用于笔记本、工作站、一体机、瘦终端、OPS、台式机、游戏主机中，是全覆盖的桌面级固态硬盘解决方案。

应用场景/Application scenario



产品规格/Product specification

形态规格

M.2 2280

可用容量(GB)

	128	256	512	1,024
TBW(TB) @JE5D219 Client Workload	65	125	250	500

性能

128KB 顺序读(MB/s) Up to 3,600

128KB 顺序写(MB/s) Up to 3,200

功耗(Watt)

≤0.1(idle); ≤3.7(active)

颗粒

3D TLC

产品接口

PCIe Gen 3x4

工作温度

0~70 °C(工作状态)
-40~+85 °C(存储状态)

平均无故障时间(MTBF)

≥1,500,000 hours

振动 / 冲击

1,500G @ 0.5 ms, 半正弦波

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得，性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

EP3000

PCIe 4.0



M.2 2280

产品简介/Product Introduction

XITC EP3000 搭载芯盛智能 PCIe4.0 控制器芯片, 采用 3D TLC NAND, 具备 PCIe4.0x4 高速接口, 支持 NVMe1.4 协议, 其内置 NANDXtra® 和 NANDSafe™ 应用技术, 大大增加了颗粒的耐久性和可靠性, 被广泛应用于笔记本、工作站、一体机、瘦终端、OPS、台式机、游戏主机中, 是全场景覆盖的桌面级固态硬盘解决方案。

自研国产主控

该产品搭载基于 RISC-V 架构自主研发的芯盛 XT8211 主控, 用户带来了安全高效的数据存储体验, 助力自研存储创新应用升级。

高性能, 高效率

EP3000 系列搭载 PCIe4.0 接口协议, 内置芯盛智能高速 Flash io、动态 SLC Cache 技术, 能够轻松应对大规模数据的高速读写需求, 确保数据流通的高效性与稳定性, 为用户带来前所未有的快速存储体验。

强兼容, 长寿命

EP3000 兼容 windows、麒麟、UOS 等全主流平台, 满足办公、游戏及设计等工作场景, 其内置 NANDXtra® 和 NANDSafe™ 应用技术, 大大增加了颗粒的耐久性和可靠性, 被广泛应用于笔记本、工作站、一体机、瘦终端、OPS、台式机、游戏主机中, 是全场景覆盖的桌面级固态硬盘解决方案。

应用场景/Application scenario



产品规格/Product specification

形态规格

M.2 2280

可用容量(GB)

	256	512	1,024	2,048
TBW(TB) @JE5D219 Client Workload	150	300	600	1200

性能

128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 5,000
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 5,000
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 600,000
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 600,000

功耗 (Watt)

≤0.5 (idle); ≤7 (active)

颗粒	产品接口	工作温度
3D TLC/QLC	PCIe Gen 4.0	0~70/-20~70 °C(工作状态) -40~+85 °C(存储状态)
平均无故障时间 (MTBF)	不可纠正错误率 (UBER)	耐用性
≥1,500,000 hours	≤10 ⁻¹⁶	0.55 DWPD (3年, 数据写入量不超过 TBW)
振动 / 冲击	特性	
20G @ 20~2000 Hz 1,500G @ 0.5 ms, 3axis	ATA Security 加密功能、安全擦功能、ECC 等纠错功能、Host Led 功能	

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second
2. 以上性能基于 X86 服务器 (SSD 直连模式) + Centos 平台下采用 FIO v3.7 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得, 性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差

An abstract graphic of a circuit board pattern in light blue on a dark blue background. The pattern consists of numerous vertical lines of varying lengths, some with horizontal segments at the top, and small circular nodes at the ends of the lines, resembling a complex network or data flow.

嵌入式存储

Embedded Storage

E110-X01小容量

eMMC 5.1



BGA153

► 产品简介 / Product Introduction

E110-X01 系列小容量产品, 采用国产设计的主控与国产的颗粒方案选型精心打造, 主要面向嵌入式领域有高可靠、高寿命需求的工业级应用市场, 如电力、能源、轨交等, 且产品本身具备 eMMC 产品本身具备优秀的抗震动、低功耗、体型小和 PIN to PIN 使用等优势。

高可靠

自主设计高可靠固件策略及 LDPC 纠错算法, 保障数据稳定性及可靠性。

高寿命

擦写次数高达 40000 cycles (pSLC), 设计满足 10 年以上工业级产品存储选型。

低功耗

优化内部电路设计和采用低功耗的器件, eMMC 能够在读写数据和处理任务时保持较低的功耗水平。

► 应用场景 / Application scenario

工业板卡



工业嵌入式系统



COM-E



工业电力设备



► 产品规格 / Product specification

形态规格

BGA153				
可用容量(GB)				
	4	8	16	32
性能				
128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 300	Up to 300	Up to 300	Up to 300
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 130	Up to 130	Up to 210	Up to 240
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 4,500	Up to 4,500	Up to 4,500	Up to 4,500
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 2,000	Up to 2,000	Up to 2,000	Up to 2,000
功耗 (mA)				
active write	80(ICC);90(ICCQ)	80(ICC);95(ICCQ)	120(ICC);95(ICCQ)	130(ICC);95(ICCQ)
active read	110(ICC);150(ICCQ)	110(ICC);150(ICCQ)	110(ICC);150(ICCQ)	120(ICC);150(ICCQ)
standby	50(ICC);95(ICCQ)	50(ICC);100(ICCQ)	70(ICC);150(ICCQ)	120(ICC);110(ICCQ)
sleep	40(ICC);70(ICCQ)	50(ICC);70(ICCQ)	60(ICC);70(ICCQ)	110(ICC);80(ICCQ)

P/E Cycles

40,000

电压

Memory Power (VCC): 3.3 V; Interface Power (VCCQ): 1.8 V or 3.3 V

颗粒

产品接口

工作温度

YMTC pSLC

eMMC 5.1

-40~85 °C (工作状态)
-40~85 °C (存储状态)

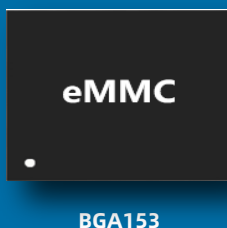
特性

LDPC、磨损均衡、巡检管理、掉电保护、系统数据保护

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second
2. 以上性能所有值均在室温25°C下, 通过HS400 Reader 使用CrystalDiskMark 进行测试, 性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差。

E110-X01大容量

eMMC 5.1



► 产品简介 / Product Introduction

E110-X01 系列大容量产品，采用国产设计的主控与国产的颗粒方案作为大容量补充，主要面向应用场景有大容量的普通工业级应用市场，如工业流媒体、工业无人机等，产品本身具备 eMMC 产品本身具备优秀的抗震动、低功耗、体型小和 PIN to PIN 使用等优势。

高可靠

自主设计高可靠固件策略及 LDPC 纠错算法，保障数据稳定性及可靠性。

大容量

满足准宽温温度情况下，产品容量最高可支持 128GB。

低功耗

优化内部电路设计和采用低功耗的器件，eMMC 能够在读写数据和处理任务时保持较低的功耗水平。

► 应用场景 / Application scenario

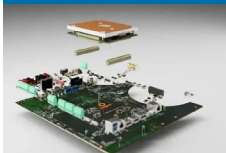
工业相机



准宽温板卡



COM-E



工业流媒体设备



► 产品规格 / Product specification

形态规格

BGA153		
可用容量(GB)	64	128
性能		
128KB 顺序读(MB/s)	Up to 295	Up to 295
128KB 顺序写(MB/s)	Up to 210	Up to 210
4K 随机读(稳态)IOPS	Up to 4,500	Up to 4,500
4K 随机写(稳态)IOPS	Up to 1,750	Up to 1,750
功耗 (mA)		
active write	95(ICC);85(ICCQ)	100(ICC);85(ICCQ)
active read	105(ICC);130(ICCQ)	105(ICC);130(ICCQ)
standby	70(ICC);105(ICCQ)	70(ICC);105(ICCQ)
sleep	75(ICC);100(ICCQ)	75(ICC);100(ICCQ)

P/E Cycles

3,000		
电压		
Memory Power (VCC): 3.3 V; Interface Power (VCCQ): 1.8 V or 3.3 V		

颗粒	产品接口	工作温度
YMTC TLC	eMMC 5.1	-40~75 °C(工作状态) -40~85 °C(存储状态)

特性

LDPC、磨损均衡、巡检管理、掉电保护、系统数据保护

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second
2. 以上性能所有值均在室温25°C下，通过HS400 Reader 使用CrystalDiskMark 进行测试，性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差。

US2200

SATA III



► 产品简介 / Product Introduction

US2200 产品系列产品，采用国产设计的主控与国产的颗粒方案选型精心打造，主要面向嵌入式领域大容量需求市场，如加固 PC、工业流媒体、工业无人机等。产品本身具备优秀的抗震动、低功耗、体型小和大容量等优势。

高可靠

自主设计控制器、高可靠固件策略及 LDPC 纠错算法，方案采用 YMTC 工业级颗粒，让工业级品质表现更加稳定可靠。

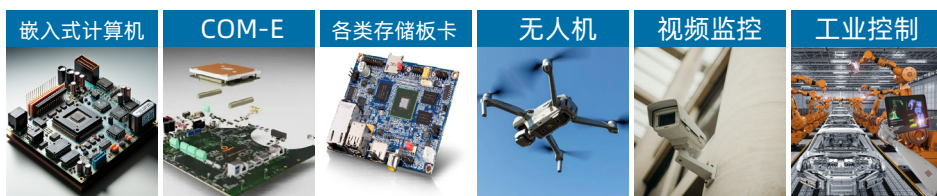
大容量

TLC 模式产品，容量最高可达 1TB，让工业嵌入式产品在狭小的空间范围内也能获得高密度存储解决方案。

低功耗

产品方案采用分离式供电方案，让产品在工作时功耗更低，续航类产品工作更加持久。

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

形态规格

	BGA156				
可用容量(GB)	60	128	256	512	1,024
性能					
128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 235	Up to 440	Up to 540	Up to 500	Up to 500
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 60	Up to 120	Up to 220	Up to 390	Up to 410
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 13,000	Up to 26,000	Up to 42,000	Up to 42,000	Up to 42,000
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 14,000	Up to 26,000	Up to 40,000	Up to 48,000	Up to 55,000

功耗 (watt)

≤0.5(idle); ≤1.5(active)

P/E Cycles

电压

3,000

VCC: 2.5 V VCCQ: 1.2 V

VDD/VDDA: 1.1 V; VDDIO/VDDHA: 3.3 V

颗粒

产品接口

工作温度

YMTC iTLC

SATA3.1

-40~85 °C(工作状态)
-40~95 °C(存储状态)

特性

安全擦功能、在线升级、高温限速、系统区 / 数据区巡检、RAID、SRAM ECC、磨损均衡、坏块管理
外部掉电保护(可选)、软销毁(可选)、硬销毁(可选)

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes ; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second
2. 在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得，性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差。

US2230

SATA III



► 产品简介 / Product Introduction

US2230 产品系列产品，采用国产设计的主控与国产的颗粒方案选型精心打造，主要面向嵌入式领域有高可靠、高寿命需求市场，如工业板卡、电力、能源、轨交等。产品本身具备优秀的抗震动、低功耗、体型小和高寿命等优势。

高可靠

自主设计控制器、高可靠固件策略及 LDPC 纠错算法，方案采用 YMTC 工业级颗粒，让工业级品质表现更加稳定可靠。

高寿命

pSLC 模式产品，擦写次效高达 60000 cycles(pSLC)，设计满足 10 年以上工业级产品存储选型。

低功耗

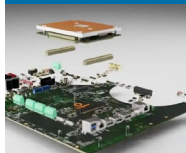
产品方案采用分离式供电方案，让产品在工作时功耗更低，续航类产品工作更加持久。

► 应用场景 / Application scenario

高规格存储板卡



COM-E



FPGA



工业控制



车载



► 产品规格 / Product specification

形态规格

可用容量(GB)	BGA156		
	32	64	128
性能			
128KB 顺序读 (MB/s)	Up to 535	Up to 560	Up to 560
128KB 顺序写 (MB/s)	Up to 385	Up to 400	Up to 410
4K 随机读 (稳态) IOPS	Up to 40,000	Up to 56,500	Up to 58,000
4K 随机写 (稳态) IOPS	Up to 58,000	Up to 59,000	Up to 60,000

功耗 (watt)

≤0.5(idle); ≤1.1(active)

P/E Cycles

60,000

电压

VCC: 2.5 V VCCQ: 1.2 V

VDD/VDDA: 1.1 V; VDDIO/VDDHA: 3.3 V

颗粒

YMTC iTLC@pSLC

产品接口

SATA3.1

工作温度

-55~85 °C(工作状态)
-55~95 °C(存储状态)

特性

安全擦功能、在线升级、高温限速、系统区 / 数据区巡检、RAID、SRAM ECC、磨损均衡、坏块管理
外部掉电保护(可选)、软销毁(可选)、硬销毁(可选)

1. 1GB=1,000,000,000 Bytes; 1 MB/s = 1,000,000 Bytes/second

2. 在 X86 + Windows 平台下基于 CrystalDiskMark V6.1 工具 (带宽和 IOPS 分别基于队列深度 Q32T1 和 Q8T8) 测试而得，性能数据因测试工具和使用环境的差异可能存在偏差。

An abstract graphic of a circuit board pattern in light blue, consisting of vertical lines and horizontal connections, with small circular nodes at various points, set against a dark blue background.

内存模组

Memory Module

XAP40A

SODIMM



产品简介 / Product Introduction

XAP40A 系列是芯盛智能专为 DDR4 平台设计的 DRAM 产品, 其传输速率高达 3200Mbps, 有效提升了设备数据传输性能, 并具备良好的平台兼容能力。

- 采用国际主流 DDR4 IC
- 支持 8GB、16GB 主流容量和规格
- 支持 3200MT/s, 满足国产和 X86 台式机、笔记本电脑处理器性能要求
- 设计、生产和测试全流程在国内完成, 供应有保障

应用场景 / Application scenario



产品规格 / Product specification

技术代次

DDR4

容量 (GB)¹

8

16

性能

时钟速度

1600 MHz

1600 MHz

传输速度

3200 MT/s

3200 MT/s

特性

总线宽度

x64

x64

带宽

PC4-25600

PC4-25600

延时

22-22-22

22-22-22

ECC

NO

NO

IC²

IC 配置

JHICC 1Gb x8
Samsung 1Gb x8
Hynix 1Gb x8

JHICC 1Gb x8
Samsung 1Gb x8
Hynix 1Gb x8

IC 数量

8

16

操作规格

操作电压

1.2V

1.2V

操作温度

0°C ~ 85°C

0°C ~ 85°C

外形尺寸 (mm)

69.6x 30

69.6x 30

1.如需更多容量需求, 请联系您的销售代表。
2.规格可能因型号、容量不同而有所差异; 实际功能以具体产品为准。

XAP40A

UDIMM



► 产品简介 / Product Introduction

XAP40A 系列是芯盛智能专为 DDR4 平台设计的 DRAM 产品, 其传输速率高达 3200Mbps, 有效提升了设备数据传输性能, 并具备良好的平台兼容能力。

- 采用国际主流 DDR4 IC
- 支持 8GB、16GB 主流容量和规格
- 支持 3200MT/s, 满足国产和 X86 台式机、笔记本电脑处理器性能要求
- 设计、生产和测试全流程在国内完成, 供应有保障

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

技术代次

DDR4

容量 (GB)¹

8

16

性能

时钟速度

1600 MHz

1600 MHz

传输速度

3200 MT/s

3200 MT/s

特性

总线宽度

x64

x64

带宽

PC4-25600

PC4-25600

延时

22-22-22

22-22-22

ECC

NO

NO

IC²

IC 配置

JHICC 1Gb x8
Samsung 1Gb x8
Hynix 1Gb x8

JHICC 1Gb x8
Samsung 1Gb x8
Hynix 1Gb x8

IC 数量

8

16

操作规格

操作电压

1.2V

1.2V

操作温度

0°C ~ 85°C

0°C ~ 85°C

外形尺寸 (mm)

133.35x 30.75

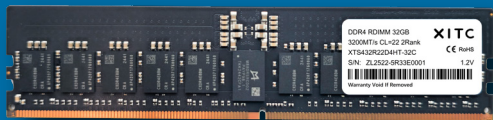
133.35x 30.75

1.如需更多容量需求, 请联系您的销售代表。

2.规格可能因型号、容量不同而有所差异; 实际功能以具体产品为准。

XAS40A

RDIMM



产品简介 / Product Introduction

DDR4 RDIMM 产品专为服务器和工作站设计, 提供 16GB、32GB 可选容量, 最高支持 3200MT/s 速率, 适用于数据库、高性能计算、虚拟化、大数据和云端服务等应用。

- 采用国际大厂主流 DDR4 IC
- 支持 16GB、32GB 主流容量和规格
- 最高支持 3200MT/s, 满足国产和 X86 服务器处理器性能要求
- 设计、生产和测试全流程在国内完成, 供应有保障

应用场景 / Application scenario



产品规格 / Product specification

技术代次

DDR4

容量 (GB)¹

16

32

性能

时钟速度

1600 MHz/1466 MHz

1600 MHz/1466 MHz

传输速度

3200 MT/s/2933 MT/s

3200 MT/s/2933 MT/s

特性

总线宽度

x72

x72

带宽

PC4-25600

PC4-25600

延时

22-22-22-52

22-22-22-52

ECC

YES

YES

IC²

IC 配置

Samsung 2Gx4/JHICC 2Gx4

Samsung 2Gx4/JHICC 2Gx4

IC 数量

18

36

操作规格

操作电压

1.2V

1.2V

操作温度

0°C ~ 85°C

0°C ~ 85°C

外形尺寸 (mm)

133.35x 30.75

133.35x 30.75

1. 如需更多容量需求, 请联系您的销售代表。

2. 规格可能因型号、容量不同而有所差异; 实际功能以具体产品为准。

XAP50A

SODIMM



► 产品简介 / Product Introduction

XAP50A 系列是芯盛智能专为 DDR5 平台设计的 DRAM 产品, 其传输速率高达 5600Mbps, 有效提升了设备数据传输性能, 并具备良好的平台兼容能力。

- 采用国际大厂主流 DDR5 IC
- 支持 16GB、32GB 主流容量和规格
- 支持 5600MT/s, 满足国产和 X86 台式机、笔记本电脑处理器性能要求
- 设计、生产和测试全流程在国内完成, 供应有保障

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

技术代次

DDR5

容量 (GB)¹

16

32

性能

时钟速度

2800 MHz

2800 MHz

传输速度

5600 MT/s

5600 MT/s

特性

总线宽度

x64

x64

带宽

PC5-44800

PC5-44800

延时

46-46-46-90

46-46-46-90

ECC

NO

NO

IC²

IC 配置

Samsung 1G x8

Samsung 2G x8

IC 数量

16

16

操作规格

操作电压

1.1V

1.1V

操作温度

0°C ~ 85°C

0°C ~ 85°C

外形尺寸 (mm)

69.6x 30

69.6x 30

1. 如需更多容量需求, 请联系您的销售代表。
2. 规格可能因型号、容量不同而有所差异; 实际功能以具体产品为准。

XAP50A

UDIMM



► 产品简介 / Product Introduction

XAP50A 系列是芯盛智能专为 DDR5 平台设计的 DRAM 产品, 其传输速率高达 5600Mbps, 有效提升了设备数据传输性能, 并具备良好的平台兼容能力。

- 采用国际大厂主流 DDR5 IC
- 支持 8GB、16GB 主流容量和规格
- 支持 5600MT/s, 满足国产和 X86 台式机、笔记本电脑处理器性能要求
- 设计、生产和测试全流程在国内完成, 供应有保障

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

技术代次

DDR5

容量 (GB)¹

16

32

性能

时钟速度

2800 MHz

2800 MHz

传输速度

5600 MT/s

5600 MT/s

特性

总线宽度

x64

x64

带宽

PC5-44800

PC5-44800

延时

46-46-46-90

46-46-46-90

ECC

NO

NO

IC²

IC 配置

Samsung 1G x8

Samsung 2G x8

IC 数量

16

16

操作规格

操作电压

1.1V

1.1V

操作温度

0°C ~ 85°C

0°C ~ 85°C

外形尺寸 (mm)

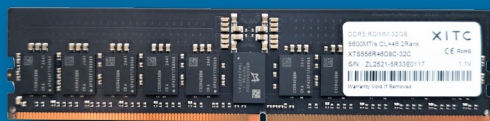
133.35x 30.75

133.35x 30.75

1. 如需更多容量需求, 请联系您的销售代表。
2. 规格可能因型号、容量不同而有所差异; 实际功能以具体产品为准。

XAS50A

RDIMM



产品简介 / Product Introduction

为新一代服务器平台打造，支持 DDR5 5600MT/s 高速传输速率，具备 32GB、64GB、96GB 大容量规格，加速传统和现代内存密集型工作负载，如虚拟化、云存储、机器学习、AI 和 高性能计算。

- 采用国际大厂主流 DDR5 IC
- 支持 32GB、64GB 主流容量和规格
- 最高支持 5600MT/s，满足国产和 X86 服务器处理器性能要求
- 设计、生产和测试全流程在国内完成，供应有保障

应用场景 / Application scenario



产品规格 / Product specification

技术代次

DDR5

容量 (GB)¹

32

64

性能

时钟速度

2800 MHz

2800 MHz

传输速度

5600 MT/s

5600 MT/s

特性

总线宽度

x80

x80

带宽

PC5-44800

PC5-44800

延时

46-46-46-90

46-46-46-90

ECC

YES

YES

IC²

IC 配置

Samsung 2Gx8
CXMT 2Gx8
Hynix 2Gx8

Hynix 4Gx4
CXMT 4Gx4

IC 数量

20

40

操作规格

操作电压

1.1V

1.1V

操作温度

0°C ~ 85°C

0°C ~ 85°C

外形尺寸 (mm)

133.35x 30.75

133.35x 30.75

1. 如需更多容量需求，请联系您的销售代表。

2. 规格可能因型号、容量不同而有所差异；实际功能以具体产品为准。

An abstract graphic of a circuit board pattern in light blue, consisting of vertical lines, horizontal lines, and small circles, set against a dark blue background.

便携式存储

Portable Storage

T100

Micro SD 卡 / Trans Flash 卡



► 产品简介 / Product Introduction

芯盛智能 T100 系列高速 Micro SD 卡 / Trans Flash 卡, 采用高品质高速闪存技术, 确保数据稳定性和耐用性。T100 系列产品支持高清照片、1080P 视频拍摄以及快速文件传输, 适用于行车记录仪、运动相机、无人机、个人电脑、平板等设备。T100 系列提供 8GB~128GB 的灵活容量配置, 具备防水、防磁、防振特性, 适应户外复杂环境, 是日常存储与内容创作的可靠选择。

灵活的容量选择

T100 系列提供 8GB~128GB 多种容量选择, 无论是办公文件存储还是高清视频记录, 都能为您找到最适合的配置。

快速转移数据

高达 85MB/s、50MB/s 的连续读取、写入速度, 能够快速转移您的重要数据, 关键时刻不用等待。

高兼容性

无论是手机、平板, 还是无人机、行车记录仪、数码相机, T100 都能完美匹配, 提供最佳兼容性。

多应用场景

T100 系列具备防水、防磁、防振、防冲击的特性。无论在室内还是户外, T100 系列都是您的最佳搭档。

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

产品外形	microSDXC				
产品尺寸	11mm x 15mm x 1mm				
兼容性	与支持 microSDHC、microSDXC 的主机设备兼容				
速度等级	UHS-I, U3, V30, Class10				
容量 (GB)	8	16	32	64	128
性能					
连续读取 (MB/s)	20	70	80	80	85
连续写入 (MB/s)	10	15	26	45	50
工作温度	0°C~70°C(工作状态); -20°C~85°C(非工作状态)				
工作湿度	8%~95% RH(非凝露状态)				
抗跌落能力	通过 IEC 60068-2-31 标准 1.5 米自由跌落测试				
耐久性	通过 IEC 60512-100 标准 10000 次拔插测试				
其它	支持卡片侦测模式, 具备纠错能力				

1. 如需更多容量需求, 请联系您的销售代表。
2. 规格可能因型号、容量不同而有所差异; 实际功能以具体产品为准。

T150

高速大容量
Micro SD 卡 / Trans Flash 卡



► 产品简介 / Product Introduction

芯盛智能 T150 系列高速大容量 Micro SD 卡 / Trans Flash 卡，让您能够自由的存储照片、视频和文件。T150 系列提供大容量、高耐久度的组合，支持 256GB~1TB 容量范围，能够帮助个人和企业应对当今社会爆发增长的数据存储需求，包括高清视频摄录、大文件存储、扩展存储等。T150 系列经过严格测试，确保稳定的产品性能和优良的用户体验。

容量高达 1TB

无论是生活、工作还是娱乐，都能借助 T150 轻松添加存储空间，存储视频、照片和其他文件。

快速转移数据

高达 70MB/s、50MB/s 的连续读取、写入速度，能够快速转移您的重要数据，关键时刻不用等待。

为高清视频存储而生

T150 系列速度等级支持 C10, U3, V30, 适合直接存储和回放全高清视频。

多应用场景

T150 系列具备防水、防磁、防振、防冲击的特性，无论在室内还是户外都可以广泛应用。

► 应用场景 / Application scenario



► 产品规格 / Product specification

产品外形	microSDXC		
产品尺寸	11mm x 15mm x 1mm		
兼容性	与支持 microSDHC、microSDXC 的主机设备兼容		
速度等级	UHS-I, U3, V30, Class10		
容量 (GB)	256 512 1024		
性能			
顺序读取 (MB/s)	70	70	70
顺序写入 (MB/s)	50	50	50
工作温度	0°C~70°C(工作状态); -20°C~85°C(非工作状态)		
工作湿度	8%~95% RH(非凝露状态)		
抗跌落能力	通过 IEC 60068-2-31 标准 1.5 米自由跌落测试		
耐久性	通过 IEC 60512-100 标准 10000 次拔插测试		
其它	支持卡片侦测模式,具备纠错能力		

1. 如需更多容量需求,请联系您的销售代表。
2. 规格可能因型号、容量不同而有所差异; 实际功能以具体产品为准。

U2000

USB2.0 固态 U 盘



► 产品简介 / Product Introduction

无论您是准备毕业论文转移重要实验数据、携带电子文案准备路演，还是拷贝照片分享视频，芯盛智能 U2000 系列经典 U 盘都是您的理想伙伴。它采用了经典 Type-A 端口设计，支持 USB2.0 协议，即插即用。U2000 系列 U 盘还采用了金属外观，更牢固，更有质感，提供超小尺寸，长度仅 32.6 毫米，不占用任何空间，拿得起放得下。U2000 系列 U 盘还支持自定义镭射图案，无论您是企业批量采购，还是礼品赠送，都能提供最具个性化的表达方式。

灵活的容量选择

U2000 系列支持 8GB~128GB 多种容量。无论是存储办公文件，还是拷贝超大电影，U2000 都能满足您的空间要求。

袖珍尺寸设计

U2000 系列在提供 Type-A 接口的同时，长度仅 32.6 毫米，袖珍身材，方便携带。

即插即用

U2000 系列支持 USB2.0 协议，即插即用。无论是新电脑还是旧电脑，都可以自在连接。

支持个性化定制

U2000 系列金属外观是个性化创意的最佳展示平台，支持镭射外观定制，您的地盘您做主。

► 产品规格 / Product specification

接口协议	USB 2.0
容量 (GB)	8GB、16GB、32GB、64GB、128GB
性能	
读取性能 (MB/s)	Up to 25
写入性能 (MB/s)	Up to 18
产品尺寸	32.6mm x 12.9mm x 4.6mm
产品重量	4.8g
工作温度	-40°C ~ +70°C(工作状态)
耐久性	大于 5000 次拔插
兼容性	Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS 10.9 及以上 Linux Kernel 2.6 及以上

1. 尾部挂扣为橡胶设计，可折叠。
2. 如需批量定制镭射外观，请联系您的销售代表。
3. 如需更多外观设计和容量，请联系您的销售代表。

U3000

USB3.2 多彩固态 U 盘



► 产品简介 / Product Introduction

芯盛智能 U3000 系列多彩 U 盘，锐意彰显您对多彩生活的不懈追求。无论是高速存储还是多设备兼容，U3000 系列都是您的最佳拍档。U3000 系列支持 USB3.2 Gen1 协议，保证高速文件传输；支持 Type-A & C 双端口，随时随地任意连接；还采用了多彩外观设计，充分体现您的无限创意。U3000 系列存储空间可达 128GB，无论是您喜欢的音乐，充满回忆的照片，还是重要的文件，统统可以放在一起。

灵活的容量选择

U3000 系列支持 8GB~128GB 多种容量。无论是存储办公文件，还是拷贝超大电影，U3000 都能满足您的空间要求。

多彩外观设计

U3000 系列支持多种颜色外观可以选择，个性的色彩，有你做主。

双端口即插即用

支持 Type-A & C 双端口设计，即插即用。无论是电脑还是手机，都可以自在连接。

高兼容性

支持 USB3.2 Gen1 协议，轻松跨平台传输资料。

► 产品规格 / Product specification

接口协议	USB 3.2 Gen1
容量 (GB)	8GB、16GB、32GB、64GB、128GB
性能	
读取性能 (MB/s)	Up to 120
写入性能 (MB/s)	Up to 50
产品尺寸	65.6mm x 19.0mm x 9.6mm
产品重量	14.8g
工作温度	-40°C ~ +70°C(工作状态)
耐久性	大于 5000 次拔插
兼容性	Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS 10.9 及以上 Linux Kernal 2.6 及以上

1、如需更多外观设计和容量，请联系您的销售代表。

U3500

USB3.2 高速固态 U 盘



► 产品简介 / Product Introduction

芯盛智能 U3500 系列高速 U 盘提供高达 500MB/s 的传输速度，专为高效率人士设计。借助于专用主控和高速闪存，U3500 系列可以充分发挥 USB3.2 Gen1 协议的最高性能，助您在电脑、手机、平板之间轻松移动文件。从此让您不再花费时间等待，数据转移立等可取。U3500 还采用了全金属外观和旋转设计，轻松放进口袋，在移动过程中为您的数据提供超强保护。

灵活的容量选择

U3500 采用专用主控和高速闪存，最高速度支持 500MB/s，文件传输快如闪电。

全金属外观设计

U3500 系列采用全金属外观设计，具备温润质感，也为您的数据提供超强保护。

双端口即插即用

支持 Type-A & C 双端口设计，即插即用。无论是电脑还是手机，都可以自在连接。

支持个性化定制

U3500 系列外观是个性化创意的最佳展示平台，支持镭射外观定制，您的地盘您做主。

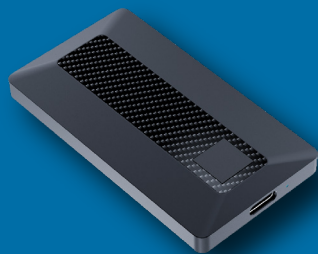
► 产品规格 / Product specification

接口协议	USB 3.2 Gen1	
产品外形	Type-A & C 二合一	
容量 (GB)	128	256
性能		
读取性能 (MB/s)	Up to 400	Up to 500
写入性能 (MB/s)	Up to 300	Up to 400
产品尺寸	67.9mm x 16.8mm x 10.0 mm	
产品重量	25g	
工作温度	-40°C ~ +70°C(工作状态)	
耐久性	大于 5000 次拔插	
兼容性	Windows 7/8/8.1/10/11 Mac OS 10.9 及以上 Linux Kernel 2.6 及以上	

1、如需更多外观设计和容量，请联系您的销售代表。

EM110

加密型移动固态硬盘



► 产品简介 / Product Introduction

以革新科技重塑移动存储体验！金属机身融合高强度复合材质，搭载 USB3.2 Gen2 高速引擎，疾速传输突破 1050MB/s，效率跃升如闪电。SED 全盘硬件加密技术及指纹识别解锁，让数据如锁入保险库般固若金汤；IP65 防水防尘与 2 米抗摔设计，无惧暴雨沙尘或意外跌落，从容应对严苛环境。轻至 100g 的名片式机身兼容多元平台，即插即用。磁吸技术一触即合，轻松链接手机、PAD、电脑等设备，拓展存储边界。256GB 至 4TB 大容量灵活选择，三年质保护航数据安全，助你掌控数字时代的每一刻高效与自由，开启智能存储新纪元。

全方位安全防护

全系标配 SED (自加密硬盘) 技术，通过独立加密芯片实现数据实时加密，数据写入即锁，破解概率趋近于零。并配置指纹解锁模块，支持多组指纹录入，解锁速度 ≤ 0.3 秒，避免传统密码遗忘风险。

高速传输

全系列采用 USB 3.2 Gen2x1 接口，传输速度可达 1050MB/s，相比 External HDD 提升约 9.5 倍，1TB 文件传输仅需数分钟。

全平台即插即用

系列产品支持全系统即插即用，兼容 Windows、macOS、Android 及 iOS 等，无缝衔接手机、平板、游戏主机等设备。

创新设计与易用性

内置强磁模块，可吸附于金属表面(如手机、脚架等)，轻松吸附，外录搭档。

► 产品规格 / Product specification

型号	EM110	EM110F	EM110S
容量	256GB/512GB/1TB/2TB/4TB		512GB/1TB/2TB/4TB
接口	USB Type-C		
尺寸	40x 74 x 8 mm		
重量	≤100g	≤100g	≤100g
SED加密	●	●	●
密码解锁	●	●	●
写保护模式	●	●	●
磁吸	●	●	●
指纹解锁	○	●	○
私密分区	○	○	●
防水性能	IP65		
抗跌落	2M		
工作温度	0°C~50°C		
系统兼容性	Windows11/10/8.1/7、Mac OS 10.11+、Android、IOS、HarmonyOS*、系统软件版本为 4.50 或更高版本的 PlayStation™		

1、1GB = 10 亿字节，1TB = 1 万亿字节。实际用户可用容量可能较少，具体取决于运行环境。
 2、以上性能基于读取速度计算。1 MB/s = 每秒传输 1 百万字节。根据内部测试，性能可能会因主机设备、使用情况、硬盘容量和其他因素而异。
 3、HarmonyOS 当前只支持“即插即用”模式。

免责声明

- 1、本手册所载信息(包括但不限于主控芯片参数、固态硬盘、DDR 模组及便携式存储产品技术规格等)仅供参考,我司保留在不另行通知的情况下进行技术调整及产品优化的权利。
- 2、本手册所述产品数据等均基于实验室环境测试得出,实际使用可能因系统配置、温度条件及负载差异而有所波动。
- 3、产品外观、功能及配件请以实物为准,商标与专利归属我司及对应权利人所有。

本声明最终解释权归芯盛智能所有,发布日期:2026年05月08日,有效使用期:2026年07月30日前。